

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成31年1月17日(2019.1.17)

【公開番号】特開2017-220543(P2017-220543A)

【公開日】平成29年12月14日(2017.12.14)

【年通号数】公開・登録公報2017-048

【出願番号】特願2016-113277(P2016-113277)

【国際特許分類】

H 01 L 23/12 (2006.01)

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/12 5 0 1 B

H 05 K 3/46 B

H 05 K 3/46 N

H 05 K 3/46 T

【手続補正書】

【提出日】平成30年11月29日(2018.11.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 0】

次に、図3(a)に示す工程では、絶縁層11の一方の面11aに、配線層14を被覆するように絶縁層15を形成する。絶縁層15の材料としては、例えば、フェノール系樹脂やポリイミド系樹脂等を主成分とする絶縁性の感光性樹脂を用いることができる。絶縁層15の厚さは、例えば5~10μm程度とすることができます。絶縁層15は、シリカやアルミナ等のフィラーを含有しても構わない。絶縁層15の材料として、液状又はペースト状の樹脂を用いた場合には、配線層14を被覆するように絶縁層11の一方の面11aに液状又はペースト状の樹脂をスピノコート法等により塗布する。絶縁層15の材料として、フィルム状の樹脂を用いた場合には、配線層14を被覆するように絶縁層11の一方の面11aにフィルム状の樹脂をラミネートする。